

平成 14 年 6 月 20 日

報道関係資料

『Electronic Design and Solution Fair 2003』  
出展募集を開始

社団法人 電子情報技術産業協会  
日本エレクトロニクスショー協会

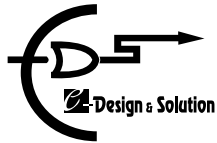
社団法人電子情報技術産業協会（会長：谷口一郎・三菱電機会長）は、EDA（Electronic Design Automation）技術、ASIC（Application Specific Integrated Circuit）やFPGA/PLD（Field Programmable Gate Array / Programmable Logic Device）をはじめとする先進のデバイス技術、設計資産（IP=Intellectual Property）再利用技術、組込ソフトウェア技術、各種設計サービスなどの分野を網羅するソリューションフェア『Electronic Design and Solution Fair 2003』を2003年1月30日（木）と31日（金）の2日間、横浜国際平和会議場（パシフィコ横浜）にて開催いたします。

3回目の開催となる『Electronic Design and Solution Fair 2003』の開催に向け、本日、世界貿易センタービル・スカイホールにて出展募集説明会を開催し、出展募集を開始いたしました。なお、募集期間は9月13日（金）まで、出展の申し込み先、問い合わせ先は日本エレクトロニクスショー協会です。

21世紀に入り、半導体産業界の最大の焦点は“高付加価値の『システム・オン・チップ（SoC）』”の動向であり、今後の業界の方向性を決定づけていくとも言われています。我が国でも、次世代半導体研究開発の「半導体MIRAI」プロジェクトや「あすか」プロジェクトにおいて、『次世代SoC』の研究が行われています。今後、ブロードバンド・デジタル・ネットワーク社会を形成していく上で、半導体・LSIの高性能化、システム・オン・チップの高度化、省エネルギー化は不可欠であり、デバイス・プロセス技術、製造技術に加え、電子回路設計技術およびソフトウェアも含めたソリューション技術の開発と進展がますます重要になりつつあります。

Electronic Design and Solution Fairは、こうした時代のニーズに応えるべく、EDA、デバイス、IP設計サービス等の先端技術を組み合わせた新しい設計技術とソリューションの提供の場として開催するものです。

また、昨年より、米国のElectronic Design Automation Conference（EDAC）との協力関係を締結し、「FPGA/PLD Design Conference」を併設、米国のDesign Automation Conference（DAC）、欧州のDesign, Automation and Test in Europe（DATE）と並ぶ



国際コンベンションとして位置付けられ、当分野におけるアジア地区最大の展示会として、国内外から高く評価されています。

さらには、産学間の技術交流を深める「ユニバーシティプラザ」をはじめとするセッションやイベントの充実を図ることにより、ご参加いただく出展者・来場者の皆様のご要望にお応えし、効率的かつ効果的なコミュニケーションとビジネスの場をご提供できるものと確信しております。多くの企業、関係者が『Electronic Design and Solution Fair 2003』へ参加されることを期待しております。

以上

Electronic Design and Solution Fair 2003 Home Page

<http://www.edsfair.com>



出展申込みおよび本件に関するお問い合わせは、下記までお願いいたします。

日本エレクトロニクスショー協会 担当：菊嶋・吉永  
〒105-0012 東京都港区芝大門1-12-16 住友芝大門ビル2号館  
電話：(03) 5402-7601

■ 『Electronic Design and Solution Fair 2003』 開催要項

- 名 称 : Electronic Design and Solution Fair 2003  
会 期 : 2003年1月30日(木)～1月31日(金) 2日間  
会 場 : 横浜国際平和会議場(パシフィコ横浜) 展示ホール  
〒220-0012 横浜市西区みなとみらい1-1-1  
開 場 時 間 : 午前10時～午後6時  
入 場 : 展示/無料(入場の際に登録が必要)、コンファレンス/一部有料  
主 催 : 社団法人電子情報技術産業協会(JEITA)  
協 力 : Electronic Design Automation Consortium(EDAC)  
後援(予定) : 経済産業省、アメリカ大使館、米国半導体工業会(SIA)、  
外国系半導体商社協会(DAFS)  
協賛(予定) : 社団法人電子情報通信学会(IEICE)、社団法人情報処理学会(IPSJ)  
社団法人日本プリント回路工業会(JPCA)  
運 営 : 日本エレクトロニクスショー協会(JESA)